计算机 | 证券研究报告 — 行业周报

2025年6月10日

# 强于大市

# 计算机行业"一周解码"

英伟达与联发科联手开发APU. 入局电竞本市场

近日, 英伟达与联发科联手开发 APU, 入局电竞本市场。软银与英特尔合作, 开发 AI 存储芯片, 有望将芯片功耗降低 50%。同时, 尊界 S800 正式上市, 首发搭载 HUAWELADS 4。

#### 支撑评级的要点

- 英伟达与联发科联手开发 APU, 入局电竞本市场。华尔街见闻 6 月 3 日 消息,全球 GPU 龙头英伟达(NVIDIA)正与联发科(MediaTek)联合开发高性能 APU(加速处理单元),计划最快于 2026 年初推向市场,并与戴尔旗下电竞品牌 Alienware 合作推出新机。
- **软银与英特尔合作,开发 AI 存储芯片。**驱动之家消息称,全球科技巨头 软银集团与芯片制造商英特尔近日宣布达成战略合作,双方将研发一种 创新的堆叠式 DRAM 芯片,采用全新的布线架构,致力于突破当前 AI 计算中的能耗瓶颈,有望将芯片功耗降低 50%。
- **專界 S800 正式上市, 首发搭載 HUAWELADS 4.** 5月 30 日, 华为与江淮汽车联合打造的尊界 S800 在深圳正式上市, 售价 70.8 万至 101.8 万元。作为鸿蒙智行体系中定位较高的车型, 尊界 S800 是双方技术融合的集大成者: 由华为提供智能化解决方案, 江淮承担制造与整车开发, 包括投资 40 亿元建设超级工厂, 实现关键工序全自动化相关事项。
- 我们认为,英伟达与联发科的合作或将对 AMD 的市场份额构成挑战,有望催生产品形态突破性技术创新,倒逼传统游戏本厂商全面革新散热系统和外观设计;此外,APU 的普及可能推动 UCIe(通用芯片互连标准)等开放标准的应用,促进不同厂商芯片的互操作性。软银与英特尔合作开发 AI 存储芯片,有望突破当前 AI 计算中的能耗瓶颈,降低芯片功耗,或将为全球 AI 基础设施建设带来革命性变化,推动计算行业向高效低耗方向演进;技术媒体 CapacityMedia 指出,若 Saimemory 的 HBM 替代方案得以普及,英特尔有望打破当前三星、SK 海力士、美光三足鼎立的HBM 市场格局。尊界 S800 的上市展现了我国在智能汽车技术领域的强大实力,不仅有助于打破国际豪华品牌的市场垄断,更有助于强化我国在全球汽车产业中的话语权;随着华为等科技企业在新能源汽车领域持续赋能,中国汽车产业将加速实现从"中国制造"向"中国智造"的转型升级,进一步提升国际竞争力。

#### 相关研究报告

《计算机行业"一周解码"》20250606 《计算机行业事件点评》20250530 《计算机行业"一周解码"》20250527

中银国际证券股份有限公司 具备证券投资咨询业务资格 计算机

证券分析师: 杨思睿

(8610)66229321

sirui.yang@bocichina.com 证券投资咨询业务证书编号: S1300518090001

#### 证券分析师: 郑静文

jingwen.zheng@bocichina.com 证券投资咨询业务证书编号: \$1300525010001

#### ■ 公司动态:

(1)金山办公:金山办公拟以 25,369.01 万元自有资金收购数科网维 31.9769%股权,交易完成后持股比例提升至 100%,实现全资控股。

(2)创业黑马:公司发布《关于参与竞买北京版信通技术有限公司部分股权的进展公告》,北京数字认证股份有限公司将其持有的北京版信通技术有限公司 36.6015%股权(认缴出资额 675.72 万元)转让给创业黑马科技集团股份有限公司。转让价款为人民币 10,248.42 万元。支付方式为创业黑马采用分期付款方式,首期付款为 30%(3,074.526 万元),剩余 70%(7,173.894 万元)在募集资金到位后 30 日内支付,并需按 LPR 支付延期利息。

#### 投资建议

考虑到英伟达与联发科联手开发的 APU 有望在未来给电竞笔记本领域带来革新,同时该 APU 集成的 NPU 有望抢占企业级 AI PC 市场,建议关注 AI PC 及电竞 PC 相关企业,包括中科创达、软通动力、智微智能、雷神科技、亿道信息等。

#### 评级面临的主要风险

■ 技术创新不及预期:政策推行不到位:下游需求景气度不稳定的风险。



# 目录

"	一周解码"——本周重点关注事件	4
	1、英伟达与联发科联手开发 APU,入局电竞本市场2、软银与英特尔合作,开发 AI 存储芯片	4
新	闻及公司动态	
	行业新闻	
风.I	险提示	9



# 图表目录

图表 1.芯片及服务器-行业动态	6
图表 2.云计算-行业动态	6
图表 3.人工智能-行业动态	
图表 4.数字经济-行业动态	7
图表 5.网络安全-行业动态	
图表 6.工业互联网-行业动态	



# "一周解码"——本周重点关注事件

# 1、英伟达与联发科联手开发 APU, 入局电竞本市场

事件:华尔街见闻 6 月 3 日消息,全球 GPU 龙头英伟达(NVIDIA)正与联发科(MediaTek)联合开发高性能 APU(加速处理单元),计划最快于 2026 年初推向市场,并与戴尔旗下电竞品牌 Alienware 合作推出新机。

英伟达与联发科的合作聚焦于异构计算的深度整合。该 APU 将采用英伟达最新的 Blackwell 架构 GPU 模块(推测为 GB206 或 GB207 精简版),并整合联发科定制的 Arm 架构 CPU 核心。Blackwell 架构基于台积电 4nm 工艺,其第三代 RT Core(光线追踪核心)和第四代 Tensor Core(专用硬件单元)可实现光线追踪性能提升 2 倍、AI 推理速度提升 4 倍的突破。联发科 Cortex-X925 之后的新一代 CPU 核心(类似天玑 9500 架构)则能提供高效的多任务处理能力,与 GPU 协同优化后,整体能效比提升约 30%。

当前游戏本市场以"独立显卡+ CPU"为主流配置,但厚重的散热模组和高功耗限制了便携性。英伟达与联发科的 APU 方案通过整合设计,有望在保持性能的同时,将机身厚度降低 15%-20%,满足用户对"轻薄电竞"的需求。

据 IDC 统计数据显示,2024 年全球游戏笔记本出货量同比增长9%,预计到2028 年中国市场出货量将达920万台,年复合增长率4.2%,这为高性能APU提供了广阔空间。同时,随着生成式AI应用的普及,用户对本地算力的需求增长。该APU集成的NPU(神经处理单元)可支持实时语音识别、图像生成等任务,与戴尔Alienware合作的新机可能预装英伟达的AI开发工具包,抢占企业级AIPC市场。据Canalys报告预测,2025年全球AIPC出货量将突破1.03亿台,占PC总出货量的40%,这一领域的竞争将成为科技巨头角力的新战场。

点评:此次合作或将对 AMD 的市场份额构成挑战,有望催生产品形态突破性技术创新,倒逼传统游戏本厂商全面革新散热系统和外观设计。此外, APU 的普及可能推动 UCIe (通用芯片互连标准: Universal Chiplet Interconnect Express)等开放标准的应用,促进不同厂商芯片的互操作性。

# 2、软银与英特尔合作, 开发 AI 存储芯片

事件:驱动之家消息称,全球科技巨头软银集团与芯片制造商英特尔近日宣布达成战略合作,双方将研发一种创新的堆叠式 DRAM 芯片,采用全新的布线架构,致力于突破当前 AI 计算中的能耗瓶颈,有望将芯片功耗降低 50%。

当前多数 AI 处理器依赖 HBM 存储大量临时数据,主要由于其显著的带宽优势,但 HBM 技术存在制造复杂、成本高、功耗大及发热快等缺陷。为攻克这些技术难题,软银与英特尔联合成立了 Saimemory 公司。Saimemory 公司将整合英特尔的核心芯片技术与东京大学等日本顶尖科研机构的专利成果,形成独特的技术优势。日本理化学研究所和神港精机等机构也表现出浓厚兴趣,可能以资金或技术支持方式参与合作。项目方还计划寻求政府层面的政策支持,为技术研发和产业化创造更有利条件。

根据项目规划,研发团队将在两年内完成芯片原型设计,之后启动量产评估程序,目标是在本世纪二十年代末实现商业化应用。项目总投资额预计达 100 亿日元(约合 5 亿元人民币),其中软银作为领投方已承诺注资 30 亿日元(约 1.5 亿元人民币)。

点评: 此次合作有望突破当前 AI 计算中的能耗瓶颈,降低芯片功耗,或将为全球 AI 基础设施建设带来革命性变化,推动计算行业向高效低耗方向演进。技术媒体 CapacityMedia 指出,若 Saimemory 的 HBM 替代方案得以普及,英特尔有望打破当前三星、SK 海力士、美光三足鼎立的 HBM 市场格局。这一突破性的存储解决方案将为 AI 技术拓展更广阔的应用空间,加速其在医疗诊断、金融服务、智能交通和智能制造等领域的深度整合与创新应用。同时,作为计算机产业链的重要环节,存储芯片的技术进步将产生显著的产业联动效应,上游的芯片制造设备与材料供应商将获得新的市场机遇,下游的系统集成商和软件开发商也将得到更优越的硬件支持,从而促进全产业链的协同创新与整体升级。



# 3、尊界S800正式上市,首发搭载 HUAWELADS 4

事件: 5月30日,华为与江淮汽车联合打造的尊界S800在深圳正式上市,售价70.8万至101.8万元。作为鸿蒙智行体系中定位较高的车型,尊界S800是双方技术融合的集大成者:由华为提供智能化解决方案,江淮承担制造与整车开发,包括投资40亿元建设超级工厂,实现关键工序全自动化相关事项。

尊界 S800 首发搭载途灵龙行平台,首创时空推理悬架,实现颠簸与弯道的事前预判,首发智驾爆胎稳定控制辅助,首发搭载 HUAWELADS 4 智能辅助驾驶系统,采用全新 WEWA 技术架构,反应更快。全向立体融合感知系统总计搭载 36 个传感器,云端世界引擎 AI 技术生成难例数据,车端世界行为模型实现端到端类人智能辅助驾驶体验。

**点评:** 尊界 S800 的上市展现了我国在智能汽车技术领域的强大实力,不仅有助于打破国际豪华品牌的市场垄断,更有助于强化我国在全球汽车产业中的话语权;随着华为等科技企业在新能源汽车领域持续赋能,中国汽车产业将加速实现从"中国制造"向"中国智造"的转型升级,进一步提升国际竞争力。



# 新闻及公司动态

# 行业新闻

# 图表 1.芯片及服务器-行业动态

公布时间	摘要	来源
6月2日	重庆御芯微自主研发10余款物联网芯片,出货量已突破1000万片。	财联社
6月2日	软银、英特尔合作研发新型 AI 内存芯片, 耗电量有望减半。	IT 之家
6月3日	百洋医药集团器官芯片及 3D 疾病模型联合实验室揭牌启用,旨在打通基础研究与临床需求之间的创新链条,加快原创科研成果的验证转化,服务精准医学和个体化治疗等重点医疗场景。	
6月3日	NVIDIA 正在为中国市场研发一款名为"B30"的降规版 AI 芯片,这款芯片将首度支持多 GPU 扩展,允许用户通过连接多组芯片来打造更高性能的计算集群。	
6月3日	北航研究团队成功研发混合随机计算 SoC 芯片。	TrendForce 集邦 咨询
6月3日	台积电 CEO 魏哲家在股东会上表示,尽管美国关税正在对台积电产生一些影响,但市场对人工智能的需求仍然强劲,芯片供不应求的局势还将继续,台积电对于未来的展望仍然非常乐观。	财联社
6月3日	雷军在小米投资者大会上披露,最新推出的小米 YU7售价不可能是网传的23.59万元,正式定价要 1-2 天前才能确定。雷军称五年前小米就开始投资研发机器人领域,目前汽车工厂正在试用相关能力,小米的汽车芯片正在研发中,预计也将很快推出。	财联社
6月3日	博通(AVGO.US)Tomahawk 6 芯片量产上市,破解 AI 算力瓶颈引巨头抢购。	智通财经
6月4日	格力电器已建立 SiC SBD 和 MOS 芯片的工艺平台, 部分产品已在公司内部批量使用。	券中社
6月4日	信义玻璃取得太阳能电池芯片放置推车专利,大大提高了装卸效率。	金融界
6月4日	明年发布的 iPhone 18 Pro、18 Pro Max 及长期传闻中的 iPhone 18 Fold, 预期都将搭载苹果 A20 芯片,并采用台积电第二代 2nm 制程(N2)打造。	新浪
6月4日	杭州电源管理芯片公司杰华特正式递表港交所,市值 140 亿,华为旗下投资平台哈勃科技、英特尔、中芯国际旗下投资平台聚芯投资分别是其第四、第五、第六大股东。	
6月5日	GlobalFoundries 宣布在美国投资 160 亿美元芯片生产支出。	电子产品世界
6月5日	三星电子最近与英飞凌和恩智浦等行业领导者合作,共同开发下一代汽车半导体技术解决方案,旨在满足未来智能汽车对高性能计算芯片日益增长的需求。	电子产品世界

资料来源: 中银证券

# 图表 2.云计算-行业动态

公布时间	摘要	来源
6月3日	微软承诺向瑞士投资 4 亿美元,用于云计算、人工智能和 GPU 交易。	Wind
6月4日	奧飞数据拟募资17.50亿元建设新一代云计算和人工智能产业园项目,新增8,92个8.8KW机柜。	5 Wind

资料来源: 中银证券



# 图表 3.人工智能-行业动态

公布时间	摘要	来源
6月2日	北京农业人工智能与机器人研究院在海淀区成立。活动中,首次发布了"奇稷 (QeeG)大模型",是全国首个在农业领域具备千万量级知识资源的大模型。	北京时间
6月2日	中关村(京西)人工智能科技园一期在北京正式竣工,该项目由门头沟区人民政府和中关村发展集团联合打造,助力北京国际科技创新中心建设。	经价观条网
6月3日	美国食品药品监督管理局,在官网上宣布推出全机构使用的人工智能工具 ELSA。	智通财经
6月3日	科技巨头 IBM 宣布收购人工智能平台 Seek AI, 进一步拓展其企业级 AI 解决方案能力。	Donews
6月3日	人工智能办公套件研发商 Context 宣布完成 1100 万美元种子轮融资,由 Lux Capital 领投, General Catalyst Partners 与高通 Qualcomm 参与投资。	
6月3日	Meta 正在推进利用包括德国在内的欧盟用户在 Facebook 和 Instagram 上公开发布的内容来训练其人工智能系统的计划。	深圳晚报
6月3日	第25届投洽会9月举行,首设低空经济、人工智能等专区。	第一财经
6月4日	加纳与阿联酋签署 10 亿美元协议,打造西非最大的人工智能和科技中心。	币界网
6月4日	AI"教父"约书亚·本吉奥(Yoshua Bengio)宣布发起非营利组织 LawZero, 致力于探索一种新的、更安全的人工智能系统,以加速科学发现并避免人工智能相关的滥用。	界面
6月4日	布鲁克菲尔德资产管理公司计划在瑞典投资 100 亿美元建设用于人工智能的数据中心。	州北江
6月4日	广西壮族自治区政府与三六零科技集团有限公司在南宁签署战略合作协议,就面向广西及东盟的人工智能和数字安全等相关产业达成一系列战略合作。	证券时报网
6月4日	亚马逊为推动人工智能发展,将斥资 100 亿美元在北卡罗来纳州建设数据中心。	财联社
6月5日	Reddit 起诉人工智能初创公司 Anthropic,指控其在未获得授权的情况下,从该社交媒体讨论网站窃取数据用于训练其人工智能模型。Reddit 表示, Anthropic 曾公开承诺不会未经授权使用数据。	

资料来源: 中银证券

# 图表 4.数字经济-行业动态

公布时间	摘要	来源
6月3日	"沪港数字经济合作计划"启动,旨在构建两地数据要素流通枢纽、优化跨场营商环境、强化科技人才联动,推动人工智能、大数据等技术在智慧城市、金融科技等场景的创新应用。	
6月4日	汕头跨境数字经济产业园启动,"西之月 1688 汕头跨境选品中心"亮相。	砍柴网

资料来源: 中银证券

# 图表 5.网络安全-行业动态

公布时间	摘要	<b>来源</b>
6月3日	EKINOPS 完成对 Olfeo 收购,强势进军网络安全领域。	光纤在线
6月4日	微软宣布启动"欧洲安全计划",向欧洲政府免费提供网络安全服务,以应对包括 AI 增强型威胁在内的网络攻击。	<sup>卫</sup> IT 之家

资料来源: 中银证券

# 图表 6.工业互联网-行业动态

公布时间	摘要	来源
6月3日	工信部发布工业互联网与船舶及石化化工行业融合指南。	工信部
6月3日	成都搭建工业互联网安全供需对接平台。	四川在线
6月4日	亚信科技携手中国信通院等启动工业互联网"星火标识×"合作计划。	新浪

资料来源:中银证券



#### 公司动态

【金山办公】金山办公拟以 25,369.01 万元自有资金收购数科网维 31.9769%股权, 交易完成后持股比例提升至 100%, 实现全资控股。

【金山办公】 2025 年 6 月 4 日向 198 名激励对象授予 279.10 万股限制性股票 (第一类 39.10 万股, 第二类 240.00 万股),占公司股本总额 0.60%。

【恒生电子】 根据 2024 年度利润分配预案:每 10 股派发现金红利 1.0 元(含税),不送股,不转增股本,以及规定:现金分红需相应调整回购价格上限。恒生电子将原回购价格上限 44.38 元/股调整为 44.28 元/股。

【用友网络】公司发布《关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告》,截至 2025 年 5 月 31 日,用友网络累计回购 3,186,790 股(占总股本 0.093%),实际回购价格区间为 9.87 元/股~18.44 元/股。

【创业黑马】公司发布《关于参与竞买北京版信通技术有限公司部分股权的进展公告》,北京数字认证股份有限公司将其持有的北京版信通技术有限公司 36.6015%股权(认缴出资额 675.72 万元)转让给创业黑马科技集团股份有限公司。转让价款为人民币 10,248.42 万元。支付方式为创业黑马采用分期付款方式,首期付款为 30% (3,074.526 万元),剩余 70% (7,173.894 万元)在募集资金到位后 30 日内支付,并需按 LPR 支付延期利息。

【宁德时代】宁德时代披露回购公司股份的进展情况。截至 2025 年 5 月 31 日,累计回购 A 股 664.1 万股,占总股本 0.1508%,成交总金额 1,550,809,971.05 元(不含交易费用),最高成交价 237.38 元/股,最低 231.50 元/股。

【广联达】广联达披露公司回购股份进展情况。截至 2025 年 5 月 31 日,公司累计回购股份 8,732,100 股,占总股本的 0.53%。最高成交价 14.20 元/股,最低成交价 13.23 元/股,成交总金额 121,956,165.8 元(不含交易费用)。

【捷顺科技】捷顺科技披露回购公司股份的进展情况。截至 2025 年 5 月 31 日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份合计 3,650,000 股,占公司总股本的 0.57%。回购股份的最高成交价为 7.30 元/股,最低成交价为 6.54 元/股,成交总金额为 25.485.808 元(不含交易费用)。

【恒生电子】恒生电子披露回购公司股份的进展情况。截至2025年5月末,公司已累计回购股份为37,200股,占公司总股本的比例为0.0020%,购买的最低价为26.76元/股、最高价为27.02元/股,已支付的总金额约为100.0943万元(不含交易费用)。

资料来源:公司公告



# 风险提示

技术创新不及预期:技术研发可能存在不及市场预期的风险。

**政策推行不到位**:国家政策出台有望提振内需、规范行业发展,但政策出台节奏和实际落地节奏难以预期。

下游需求景气度不稳定的风险:全球经济形势的变化,尤其是经济增长放缓或衰退,可能导致下游需求减弱,政府对产业政策的调整,可能对下游需求产生影响。



# 披露声明

本报告准确表述了证券分析师的个人观点。该证券分析师声明,本人未在公司内、外部机构兼任有损本人独立性与客观性的其他职务,没有担任本报告评论的上市公司的董事、监事或高级管理人员;也不拥有与该上市公司有关的任何财务权益;本报告评论的上市公司或其它第三方都没有或没有承诺向本人提供与本报告有关的任何补偿或其它利益。

中银国际证券股份有限公司同时声明,将通过公司网站披露本公司授权公众媒体及其他机构刊载或者转发证券研究报告有关情况。如有投资者于未经授权的公众媒体看到或从其他机构获得本研究报告的,请慎重使用所获得的研究报告,以防止被误导,中银国际证券股份有限公司不对其报告理解和使用承担任何责任。

### 评级体系说明

以报告发布日后公司股价/行业指数涨跌幅相对同期相关市场指数的涨跌幅的表现为基准:

## 公司投资评级:

买 入: 预计该公司股价在未来 6-12 个月内超越基准指数 20%以上;

增 持: 预计该公司股价在未来 6-12 个月内超越基准指数 10%-20%;

中 性: 预计该公司股价在未来 6-12 个月内相对基准指数变动幅度在-10%-10%之间;

减 持:预计该公司股价在未来 6-12 个月内相对基准指数跌幅在 10%以上;

未有评级: 因无法获取必要的资料或者其他原因, 未能给出明确的投资评级。

#### 行业投资评级:

强于大市: 预计该行业指数在未来 6-12 个月内表现强于基准指数;

中 性:预计该行业指数在未来 6-12 个月内表现基本与基准指数持平;

弱于大市: 预计该行业指数在未来 6-12 个月内表现弱于基准指数:

未有评级:因无法获取必要的资料或者其他原因,未能给出明确的投资评级。

沪深市场基准指数为沪深 300 指数;新三板市场基准指数为三板成指或三板做市指数;香港市场基准指数为恒生指数或恒生中国企业指数;美股市场基准指数为纳斯达克综合指数或标普 500 指数。

#### 风险提示及免责声明

本报告由中银国际证券股份有限公司证券分析师撰写并向特定客户发布。

本报告发布的特定客户包括: 1) 基金、保险、QFII、QDII 等能够充分理解证券研究报告, 具备专业信息处理能力的中银国际证券股份有限公司的机构客户; 2) 中银国际证券股份有 限公司的证券投资顾问服务团队,其可参考使用本报告。中银国际证券股份有限公司的证券 投资顾问服务团队可能以本报告为基础,整合形成证券投资顾问服务建议或产品,提供给接 受其证券投资顾问服务的客户。

中银国际证券股份有限公司不以任何方式或渠道向除上述特定客户外的公司个人客户提供本报告。中银国际证券股份有限公司的个人客户从任何外部渠道获得本报告的,亦不应直接依据所获得的研究报告作出投资决策;需充分咨询证券投资顾问意见,独立作出投资决策。中银国际证券股份有限公司不承担由此产生的任何责任及损失等。

本报告内含保密信息,仅供收件人使用。阁下作为收件人,不得出于任何目的直接或间接复制、派发或转发此报告全部或部分内容予任何其他人,或将此报告全部或部分内容发表。如发现本研究报告被私自刊载或转发的,中银国际证券股份有限公司将及时采取维权措施,追究有关媒体或者机构的责任。所有本报告内使用的商标、服务标记及标记均为中银国际证券股份有限公司或其附属及关联公司(统称"中银国际集团")的商标、服务标记、注册商标或注册服务标记。

本报告及其所载的任何信息、材料或内容只提供给阁下作参考之用,并未考虑到任何特别的 投资目的、财务状况或特殊需要,不能成为或被视为出售或购买或认购证券或其它金融票据 的要约或邀请,亦不构成任何合约或承诺的基础。中银国际证券股份有限公司不能确保本报 告中提及的投资产品适合任何特定投资者。本报告的内容不构成对任何人的投资建议,阁下 不会因为收到本报告而成为中银国际集团的客户。阁下收到或阅读本报告须在承诺购买任何 报告中所指之投资产品之前,就该投资产品的适合性,包括阁下的特殊投资目的、财务状况 及其特别需要寻求阁下相关投资顾问的意见。

尽管本报告所载资料的来源及观点都是中银国际证券股份有限公司及其证券分析师从相信可靠的来源取得或达到,但撰写本报告的证券分析师或中银国际集团的任何成员及其董事、高管、员工或其他任何个人(包括其关联方)都不能保证它们的准确性或完整性。除非法律或规则规定必须承担的责任外,中银国际集团任何成员不对使用本报告的材料而引致的损失负任何责任。本报告对其中所包含的或讨论的信息或意见的准确性、完整性或公平性不作任何明示或暗示的声明或保证。阁下不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断。本报告仅反映证券分析师在撰写本报告时的设想、见解及分析方法。中银国际集团成员可发布其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告,亦有可能采取与本报告观点不同的投资策略。为免生疑问,本报告所载的观点并不代表中银国际集团成员的立场。

本报告可能附载其它网站的地址或超级链接。对于本报告可能涉及到中银国际集团本身网站以外的资料,中银国际集团未有参阅有关网站,也不对它们的内容负责。提供这些地址或超级链接(包括连接到中银国际集团网站的地址及超级链接)的目的,纯粹为了阁下的方便及参考,连结网站的内容不构成本报告的任何部份。阁下须承担浏览这些网站的风险。

本报告所载的资料、意见及推测仅基于现状,不构成任何保证,可随时更改,毋须提前通知。 本报告不构成投资、法律、会计或税务建议或保证任何投资或策略适用于阁下个别情况。本 报告不能作为阁下私人投资的建议。

过往的表现不能被视作将来表现的指示或保证,也不能代表或对将来表现做出任何明示或暗示的保障。本报告所载的资料、意见及预测只是反映证券分析师在本报告所载日期的判断,可随时更改。本报告中涉及证券或金融工具的价格、价值及收入可能出现上升或下跌。

部分投资可能不会轻易变现,可能在出售或变现投资时存在难度。同样,阁下获得有关投资的价值或风险的可靠信息也存在困难。本报告中包含或涉及的投资及服务可能未必适合阁下。如上所述,阁下须在做出任何投资决策之前,包括买卖本报告涉及的任何证券,寻求阁下相关投资顾问的意见。

中银国际证券股份有限公司及其附属及关联公司版权所有。保留一切权利。

### 中银国际证券股份有限公司

中国上海浦东 银城中路 200 号 中银大厦 39 楼 邮编 200121

电话: (8621) 6860 4866 传真: (8621) 5888 3554

## 相关关联机构:

### 中银国际研究有限公司

香港花园道一号 中银大厦二十楼 电话:(852) 3988 6333

致电香港免费电话:

中国网通 10 省市客户请拨打: 10800 8521065 中国电信 21 省市客户请拨打: 10800 1521065

新加坡客户请拨打: 800 852 3392

传真:(852) 2147 9513

#### 中银国际证券有限公司

香港花园道一号 中银大厦二十楼 电话:(852) 3988 6333 传真:(852) 2147 9513

#### 中银国际控股有限公司北京代表处

中国北京市西城区 西单北大街 110 号 8 层 邮编:100032

电话: (8610) 8326 2000 传真: (8610) 8326 2291

#### 中银国际(英国)有限公司

2/F, 1 Lothbury London EC2R 7DB United Kingdom 电话: (4420) 3651 8888 传真: (4420) 3651 8877

# 中银国际(美国)有限公司

美国纽约市美国大道 1045 号 7 Bryant Park 15 楼 NY 10018

电话: (1) 212 259 0888 传真: (1) 212 259 0889

#### 中银国际(新加坡)有限公司

注册编号 199303046Z 新加坡百得利路四号 中国银行大厦四楼(049908) 电话: (65) 6692 6829 / 6534 5587 传真: (65) 6534 3996 / 6532 3371